

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年12月16日 (16.12.2004)

PCT

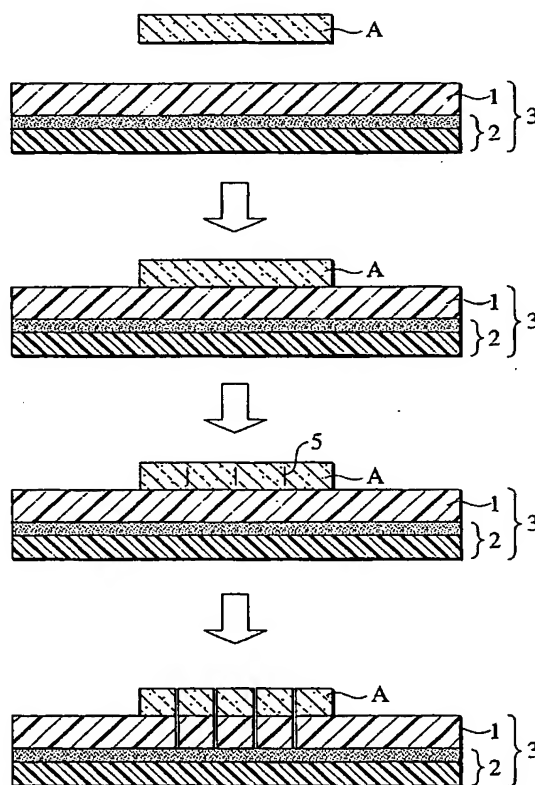
(10) 国際公開番号
WO 2004/109786 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/301, C09J 7/00, H01L 21/52
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008150
(22) 国際出願日: 2004年6月4日 (04.06.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-161656 2003年6月6日 (06.06.2003) JP
特願2003-402748 2003年12月2日 (02.12.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 稲田 禎一 (IN-ADA, Teiichi) [JP/JP]. 増野 道夫 (MASHINO, Michio) [JP/JP]. 宇留野 道生 (URUNO, Michio) [JP/JP].
(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE SHEET, DICING TAPE INTEGRATED TYPE ADHESIVE SHEET, AND SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: 接着シート、ダイシングテープ一体型接着シート、及び半導体装置の製造方法



(57) Abstract: The invention provides an adhesive sheet which can be stuck to a wafer at low temperatures of 100°C or below, which is soft to the extent that it can be handled at room temperature, and which can be cut simultaneously with a wafer under usual cutting conditions; a dicing tape integrated type adhesive sheet formed by lamination of the adhesive sheet and a dicing tape; and a method of producing a semiconductor device using them. In order to achieve this object, the invention is characterized by specifying the breaking strength, breaking elongation, and elastic modulus of the adhesive sheet in particular numerical ranges.

(57) 要約: 本発明は、100°C以下の低温でウエハに貼付可能であり、室温で取扱い可能な程度に柔軟であり、かつ、通常に行われる切断条件において、ウエハと同時に切断可能である接着シート、該接着シートとダイシングテープを積層してなるダイシングテープ一体型接着シート、およびこれらを用いた半導体装置の製造方法を提供するために、接着シートの破断強度、破断伸び、弾性率をそれぞれ特定の数値範囲に規定することを特徴とするものである。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書